

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

上海合晶硅材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
会议主题	走进郑州合晶调研暨公司近况交流会
参与单位名称	共 9 家机构，参会机构名单详见附表
时间	2025 年 10 月 17 日
地点	郑州
上市公司接待人员姓名	董事长 毛瑞源 郑州合晶 董事长、总经理 钟佑生 董事会秘书 庄子祯 财务总监 方时彬
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1：公司目前以及未来的产品布局规划是什么？ 答复：目前，上海合晶主要有三个厂，扬州合晶生产 6 英寸和 8 英寸的晶棒；上海晶盟生产 6 英寸、8 英寸、12 英寸外延片；郑州合晶负责 8、12 英寸的长晶、切磨、抛光等一体化环节。 公司短期目标是到明年底 12 英寸产能达到 10 万片/月，4 万片/月 POWER 用外延片，6 万片/月 CIS 用外延片。同时，公司正在进行逻辑用 P/P-28nm 用外延片的研发送样，长期规划未来实现 10 万片/月 P/P-用外延片量产。 公司当前产能规划是：12 英寸外延片产能目前 4 万片/月，主要用在 POWER；预计郑州二期新增 6 万片/月 12 英

	寸外延片，主要用在 CIS，今年年底小部分量产，明年一季度、二季度逐步增加，明年年底落实。公司长远规划还有郑州三期，未来再增加 10 万片/月 P/P-用外延片量产。 问题 2：和国内比较内卷的竞争对手相比，公司有哪些优势值得关注？ 答复：公司的产品具备差异化优势。在 8 英寸产品领域，公司通过重点推进 8 英寸超（极）重掺长晶研发、8 英寸多层梯度外延工艺研发、8 英寸超阻值均匀性超厚外延工艺研发等项目，目标成为标杆。在 12 英寸领域，公司聚焦高端产品，如 55nmCIS 和 28nmLOGIC。此外，上海合晶是全世界最早一批进入 POWER 领域的，未来将聚焦高端 POWER 领域，同时借助 POWER 和国际大厂的合作经验加速导入高端 CIS 领域，未来希望应用于 5000 万像素的手机用 CIS 和车规级 CIS。 公司的客户资源较为优质。公司向全球前十大晶圆代工厂中的 7 家以及全球前 10 大功率器件 IDM 厂中的 6 家公司供货，如华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、安森美等。 和大多数国内同业不同，上海合晶采取分步建设策略。公司采用迭代发展的模式，从 4 英寸到 6 英寸、8 英寸再到 12 英寸，从 POWER 用到 CIS 用到 P/P-用，逐步扩大产能。这种分步建设的策略避免了重资本投入带来的风险，同时有利于经验的积累和技术的提升。 问题 3：在公司扩产的过程中，如何处理折旧方面的压力？ 答复：折旧压力一定存在，公司以 8 寸支持 12 寸，12 寸线分步扩产。上海晶盟和郑州合晶一期折旧压力比较小，我们靠着旧厂获利支持 12 寸的发展。此外，12 寸线分三期扩产，一期 4 万片/月 POWER 用，二期明年年底建成
--	---

	6 万片/月 CIS 模拟芯片用，未来再建 10 万片/月 P/P-逻辑用，分步扩产使投入和财务压力相对较低。 问题 4：公司的毛利率和同行相比有明显的差异，请问原因是什么？ 答复：公司采取差异化竞争的产品策略，具有 20 年以上的技术、高质量产品和优质客户积累，避免卷入国内的内卷市场，以维持公司的稳定获利。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及。
附件清单（如有）	

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称
1	中信证券股份有限公司
2	中国国际金融股份有限公司
3	中邮证券有限责任公司
4	国金证券股份有限公司
5	东北证券股份有限公司
6	华安证券股份有限公司
7	青骊投资管理（上海）有限公司
8	上海汐泰投资管理有限公司
9	北京金九瑞和私募基金管理有限公司